

深圳市联得自动化装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：联得装备

证券代码：300545

编号：2025-003

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐其他_____
参与单位名称及人员 姓名	第一场：现场调研 西南证券、国泰君安证券共 2 人 第二场：现场调研 宝盈基金共 4 人
时间	2025 年 2 月 27 日
地点	东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室
上市公司接待人员 姓名	董事长、总经理：聂泉先生 董事、董事会秘书：刘雨晴女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司概况 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。 二、投资者会议问答交流 Q1：公司这几年发展步伐非常快，主要原因是什么？ A1：一是公司坚持创新驱动，加强前瞻性技术布局，并加速技术优势到产品的转化，优化产品结构，实现国产替代。二是公司积极开拓海外市场，坚持差异化和高端化定位，实现了设备在欧洲、东南亚、北美的落地。凭借卓越的设备性能、先进的技术水平、精湛的工艺设计、强大的交期掌控能力和完善的售后服务体系获得了海外大客户的广泛认可。三是公司持续优化管理流程，提升研、产、供、销的联动效率，不断强化内部协同，提升运营效率。坚持推行降本增效举措，推行精细化成本核算与管理，通

过开源和节流相结合，提升人均创利水平。四是优秀的人才战略与企业文化驱动公司高质量和可持续发展。

Q2：公司在三折屏供应链中有提供哪些设备？

A2：公司在三折屏供应链中，提供了贴合类工艺设备的整体解决方案，已形成销售订单并出货。公司作为折叠屏贴合类设备相关细分市场的领先企业，持续发挥技术领先优势，为“中国智造”贡献力量。

Q3：公司在 VR/AR/MR 显示领域有哪些产品和客户？

A3：公司通过不断推陈出新打破技术壁垒，持续自主研发创新，研发的设备已经赢得了 VR/AR/MR 等新型显示领域客户的青睐。在 VR/AR/MR 显示设备领域，公司提供其显示器件生产工艺中所需的设备，相关产品已与合肥视涯等客户建立了合作关系。

Q4：公司在半导体先进封装领域进展如何？

A4：公司一直积极布局半导体领域，已经凭借研发成功的半导体 IC 封装设备顺利切入半导体封测行业。在先进封装领域，公司有针对显示驱动芯片键合设备，COF 倒装设备，该倒装设备是一种采用共晶+倒装的芯片键合工艺的高精度高速度先进封装设备。公司将密切关注行业发展动态和前沿技术的发展趋势，积极创造并把握半导体设备领域的发展机遇。

Q5：公司在 Mini/Micro LED 领域生产的相关设备有哪些？

A5：公司目前在 Mini/Micro LED 显示领域，已经推出芯片分选设备、芯片扩晶设备、检测设备、真空贴膜设备、芯片巨量转移设备、高精度拼接设备等。

Q6：公司未来的发展战略是什么？

A6：公司将持续加强在半导体显示模组设备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备及新能源装备领域的研发。积极开拓柔性显示模组设备及显示前端工序贴合类设备、Mini/Micro LED 设备、VR/AR/MR 精密组装设备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备以及新能源装备在新兴领域的应用市场，同时继续加大这些领域的新技术、新产品研发力度，支撑该业务快速成长。

附件清单（如有）	无
日期	2025-2-27